

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



G00002



(43) 国際公開日
2002 年 7 月 4 日 (04.07.2002)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 02/051940 A1

- (51) 国際特許分類⁷: C08L 101/00, C08K 3/04, 7/02 (72) 発明者: 宮下 貴之 (MIYASHITA, Takayuki); 〒416-8533 静岡県 富士市 宮島 9 7 3 番地 ポリプラスチック株式会社内 Shizuoka (JP). 大竹 峰生 (OHTAKE, Mineo); 〒416-8533 静岡県 富士市 宮島 9 7 3 番地 ポリプラスチック株式会社内 Shizuoka (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP01/11143
- (22) 国際出願日: 2001 年 12 月 19 日 (19.12.2001)
- (25) 国際出願の言語: 日本語 (74) 代理人: 古谷 馨, 外 (FURUYA, Kaoru et al.); 〒103-0007 東京都 中央区 日本橋浜町 2-1 7-8 浜町花長ビル 6 階 Tokyo (JP).
- (26) 国際公開の言語: 日本語 (81) 指定国 (国内): CN, SG.
- (30) 優先権データ:
特願 2000-392903
2000 年 12 月 25 日 (25.12.2000) JP
添付公開書類:
— 国際調査報告書
- (71) 出願人: ポリプラスチック株式会社 (POLYPLASTICS CO., LTD.) [JP/JP]; 〒541-0052 大阪府 大阪市 中央区 安土町 2 丁目 3 番 1 3 号 Osaka (JP).
2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: SEMICONDUCTIVE RESIN COMPOSITION AND FORMED ARTICLE

(54) 発明の名称: 半導電性樹脂組成物及び成形品

(57) Abstract: A semiconductive resin composition which comprises 100 parts by weight of a liquid crystal polymer (A), 1 to 50 parts by weight of graphite (B) having a fixed carbon content of 95 wt % or more, 1 to 50 parts by weight of a fibrous conductive filler (C) and 1 to 50 parts by weight of a fibrous non-conductive filler (D), with the proviso that the sum of the amounts of (B), (C) and (D) is 25 to 100 parts by weight relative to 100 parts by weight of (A), and that (B):(C) = 1:3 to 4:1 and [(B)+(C)]:(D) = 1:2 to 2:1, and has a volume resistivity of 1×10^4 to $1 \times 10^{11} \Omega \cdot \text{cm}$. The semiconductive resin composition exhibits stable antistatic property without significant reduction in mechanical properties, and thus can be suitably used particularly for electronic parts.

(57) 要約:

電子部品に特に好適に用いられる、機械的性質を大きく低下させることなく安定した帯電防止性が付与された半導電性の液晶性ポリマー組成物を提供する。すなわち、液晶性ポリマー (A) 100 重量部に、固定炭素 95 重量%以上の黒鉛 (B) 1 ~ 50 重量部、繊維状導電性充填材 (C) 1 ~ 50 重量部及び繊維状非導電性充填材 (D) 1 ~ 50 重量部を、(B)、(C)、(D) 成分の総配合量が (A) 100 重量部に対し 25 ~ 100 重量部であり、(B) : (C) = 1 : 3 ~ 4 : 1、且つ [(B) + (C)] : (D) = 1 : 2 ~ 2 : 1 の比率を満足する範囲で配合してなる、体積抵抗率が $1 \times 10^4 \sim 1 \times 10^{11} \Omega \cdot \text{cm}$ である半導電性樹脂組成物である。

WO 02/051940 A1

162162